As 保护下的生长中断时间对 AlSb/InAs 超晶 格界面粗糙度的影响*

李志华 王文新 対林生 蒋中伟 高汉超 周均铭

(中国科学院物理研究所,北京 100080)(2006年4月26日收到2006年9月16日收到修改稿)

用分子束外延设备(MBE)在 GaA.(100) 衬底上生长了 InSb 型界面的 AlSb/InAs 超晶格,界面生长过程中采用了 As 保护下不同的中断时间.运用掠入射 X 射线反射技术(GIXRR) 对样品进行了测量,并对测量结果进行了模拟和 分析,发现 As 保护下生长中断 20 s 能获得最平整的 AlSb/InAs 界面.结合分析显微镜下观察到的样品形貌,过短的 界面中断时间会导致界面富 In 并形成 In 点,而过长的中断时间会导致 AlAs 型界面的形成,两者都使界面变得粗 糙.另外,还讨论了生长中断在分子束外延生长中的应用.

关键词:分子束外延,生长中断,超晶格,掠入射 X 射线反射 PACC:8115,6110F,7340L,7280E

1.引 言

因为 InAs 和 AlSb 之间高达 1.35 eV 的导带不 连续性,以及 InAs 材料的高电子迁移率,室温下能 达到 30000 cm²/V^[1],使得 AlSb/InAs 异质结在电子 器件领域有着广阔的应用前景,例如,高电子迁移率 晶体管^[2,3],异质结双极晶体管^[4,5]和共振遂穿二极 管^[6].半导体器件的光学、电学等性能对异质结界面 性质是非常敏感的.AlSb/InAs 异质结界面因为两边 的Ⅲ,V 族元素全部改变了,所以能形成 InSb 型和 AlAs 型两种界面.已有研究者证明 InSb 型界面能给 InAs/AlSb 量子阱带来更好的电子迁移特性^[7,8],因 为 InSb 比 AlAs 更容易形成平整的突变界面^[9],并有 效地减少材料中的位错密度^[10].

但是,要获得高质量的 InSb 型界面并不容易, 界面质量依赖于生长温度、各源的束流大小以及界 面生长时的快门控制等因素.对于 AlSb/InAs 异质 结,在界面生长过程中调整合适的生长中断时间是 很重要的^[11-13].

本文采用了不同的 As 保护中断时间生长了五 个 AlSb/InAs 超晶格样品,并用 GIXRR 等方法对其 进行了测量和分析.

2. GIXRR 原理

近年来,GIXRR 技术(也称为小角度镜面反射) 逐渐成为了分析表面和界面的有力工具^[14—16].下面 简单介绍 GIXRR 技术的原理及进行界面粗糙度模 拟所涉及到的相关理论.

假如一束平面波入射到一个包含 N 层外延膜 的样品上,经过每一个界面时,波的传播都分成反射 和透射两部分,第 l 个界面的反射率可由 Parratt 递 归公式得到^[17]

$$R_{l} = \frac{E_{l,x}}{E_{l,x}} = \exp(2ik_{z,l}z_{l}) \times \frac{r_{l} + R_{l+1}\exp(-2ik_{z,l+1}z_{l})}{1 + r_{l}R_{l+1}\exp(-2ik_{z,l+1}z_{l})}, \quad (1)$$

其中 , E_{l_x} 和 E_{l_x} 表示第 l 个界面上反射波和透射波的振幅 , k_{z_d} 表示第 l 个界面 z 方向的波矢分量 ,表示为

$$k_{z,l} = k \sqrt{n_l^2 - \cos^2 \theta}$$

 n_l 为第l 层材料的折射率 , θ 为波的入射角度. Z_l 表示第l 个界面的位置 , r_l 为第l 个界面的 Fresnel 反射系数 表示为

^{*}国家自然科学基金(批准号 50572120)资助的课题.

[†] E-mail:wxwang@aphy.iphy.ac.cn

$$_{l} = \frac{k_{z,l} - k_{z,l+1}}{k_{z,l} + k_{z,l+1}}.$$
 (2)

对于半无限衬底,根据初始条件 R_{N+1}=0,可以 由递归方程(1)解出多层膜的反射系数.

上面考虑的是理想的突变平整界面,现实中的 界面存在有一定的粗糙度.假设界面的宽度不太大, 界面各点与其平均位置的偏离服从以 σ₁ 为变量的 Gauss 分布

$$P_{l}(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_{l}}} \exp\left(-\frac{z^{2}}{2\sigma_{1}^{2}}\right)$$

则可以得出受界面粗糙影响的 Fresnel 反射系数的 修正值,记为 r, 即

 $r_{l} = r_{l} \exp(-2k_{z,l}k_{z,l+1}\sigma_{l}^{2})$, (3) 其中 σ_{l}^{2} 即为第 l 个界面的均方根粗糙度 . 详细介绍 见文献 18].

3. 实验结果与讨论

3.1. 样品生长

我们的实验样品是在 VG V80H 型分子束外延 系统上生长的.该系统采用了阀控 As 裂解炉以及传 统的 Sb 束源炉,提供 As₂ 和 Sb₄.材料生长前,GaAs 衬底先在 As 保护气氛下升温至 580℃脱氧化膜,然 后降至 570℃生长 3000 Å纯 GaAs,以获得一个平整 的 GaAs 表面,然后在 570℃生长 300Å的 AlSb 成核 层,衬底温度降至 510℃生长 1 μ m 的 GaSb 缓冲层, 最后在 470℃生长 20 周期的 AlSb/InAs 超晶格.





超晶格下界面(AlSb-InAs)的生长方法描述如下:AlSb 生长结束后,先关闭 Al 快门,Sb 快门仍然保持打开 10 s,以保证 Al 原子充分迁移并在样品表面铺满了 Sb 原子,然后关闭 Sb 快门的同时,打开 In 快门,在样品表面沉积一个原子层的 In,我们采用 InAs 的生长速率为 2000Å/h,所以沉积一个单层 In 的时间大约为 5 s,然后关闭 In 快门,中断 5 s,因为 In 原子在表面的迁移速度较快 5 s时间足以得到平整

的 In 表面.然后打开 As 快门,让样品在 As 保护下中 断 0—40 s 最后打开 In 快门开始 InAs 层的生长.对 于上界面(InAs-AlSb),因为 In 迁移较快,容易得到 InAs 平整表面,并且为了减少实验中的变量,所以在 InAs 生长结束后,我们仅采用了 10 s 的 Sb 保护中断, 以形成 InSb 型界面,然后打开 AI 快门开始 AlSb 层的 生长.整个过程如图 1 所示,图 1 中的阴影部分表示 As 保护中断时间,这是本实验中的唯一变量.本实验 生长了 5 个样品,命名为 *A*,*B*,*C*,*D*,*E*,对应的 As 保 护中断时间分别为 0,10 20 30 40 s.

3.2. 样品的测量和分析

GIXRR 测量在高分辨 X 射线衍射仪(BEDE D1) 上进行.与常规的高角度双晶衍射不同,GIXRR 扫 描需要高强度和高准直的 X 射线源,而对 X 射线的 单色性要求不如双晶衍射那么严格.为了获得高准 直度的 X 射线,在 X 射线出射端和接收端分别加一 个 50 μm 和 100 μm 宽的夹缝,比常规高角度衍射所 用的夹缝宽度小一个数量级,同时把光源部分作单 色器用的两个晶体移走第一个,仅用第二个晶体作 为单色器,以获得足够高强度的 X 射线.本实验采 用的扫描计数时间和步长分别为 8 s 和 10 弧秒.



图 2 掠入射 X 射线反射曲线及模拟曲线 为清晰起见 ,各曲线 做了相对平移)

图 2 给出了五个样品的 GIXRR 扫描曲线以及 用 Bede 公司提供的专业软件对其进行模拟所得到 的曲线.从图2可以看出 模拟曲线与实验曲线吻合 得非常好.对于样品 A, F 和 E, 随着入射角度的增 加 总体反射强度下降得很快 对于样品 B 和 C ,反 射强度下降比较缓慢,Bragg峰的强度较大,而且在 较大的反射角仍然有明显的 Bragg 峰.因为反射强 度对界面粗糙度是很敏感的 界面越粗糙 反射强度 随扫描角度的增加下降越快,所以样品 B 和 C 的界 面质量明显优于样品A, F 和E. Bragg 峰是因为 X 射线的反射在特定角度得到周期性的叠加而形成 的 Bragg 峰之间的间距由超晶格的周期厚度直接决 定,对于单层膜或者没有周期性的多层膜,反射曲线 的振幅会很弱 如果界面质量不太好 可能根本测不 出振幅 对不同样品的比较造成困难 这正是我们选 择超晶格结构做界面分析的原因。



图 3 InAs/AlSb 超晶格上下界面的粗糙度与 As 保护下中断时间的关系

通过对实验曲线的模拟,可以得到所有超晶格 样品的厚度和界面粗糙度值.本实验设计的超晶格 AlSb为160Å,InAs为80Å,与模拟结果相符.粗糙度 值在图3中给出.从图3可以看出,五个样品的下界 面粗糙度随着As保护中断时间的不同变化很大,在 As保护中断时间为20s时界面最平整,均方根粗糙 度值为7Å,随着中断时间的减小或增加,界面都变 粗糙.上界面粗糙度的变化趋势和下界面一致,但是 变化幅度要平缓得多.因为所有样品的上界面生长 程序并没有不同,所以上界面粗糙度的起伏是受不 同下界面粗糙度的影响而导致的.

图 4 给出了所有样品的(004)面 X 射线双晶衍 射的摇摆曲线.从摇摆曲线的卫星峰出现的数量,强



图 4 X 射线 004)面 2*θ* 扫描摇摆曲线 为清晰起见,各曲线做 了相对平移)

度以及半高宽的比较,也可以看出样品 B 和 C 的晶体质量明显优于其他三个样品.

As保护中断时间过短或过长,界面都变粗糙, 但是机理是不一样的,中断时间过短,没有足够的 As原子与 In 键合,会造成界面处富 In,过量的 In原 子可能聚集成点,导致界面质量变差.中断时间过 长,过量的 As原子将有可能取代 In原子层下面的 Sb原子,从而形成 AlAs型界面,导致粗糙度增加,同 时,过长的中断时间还可能造成界面吸附杂质.图 5 给出了样品 A,C 和 E 在光学显微镜下观察到的形 貌.从图 5 可以看出,A 样品表面出现了大量的细点, 我们认为这是超晶格界面处的 In 过量而形成的 In 点.样品 E 由于界面生长中断时间过长,整个表面都 显得很粗糙,但没有形成像样品 A 一样的细点.样品 C 的表面在相同放大倍数下则显得非常光滑.

3.3. 生长中断讨论

生长中断是异质结界面生长中为了提高界面质 量而常采用的一种手段,最常见的就是不同生长温 度的两种材料进行转换时,为了调整到适合下一材 料生长的衬底温度而采用生长中断,如本实验中 AlSb/GaSb 的转换.这种中断必须在相应的V族保护



图 5 样品 A(a), C(b), E(c)在显微镜下的形貌

气氛下进行,否则容易导致外延层表面Ⅲ族元素的 脱附,并且,在保证温度达到稳定的前提下,中断时 间越短越好.另一种生长中断是为了使样品表面原 子充分迁移,得到平整的表面,如本实验中在一个原 子层的 In 束流后中断 5 s.上述两种生长中断时间 不宜过长的主要原因是为了避免界面吸附杂质.事 实上,在超高真空条件下,上述的中断时间稍长也不 会对的界面质量产生明显影响,所以我们没有对这 两种生长中断进行仔细优化.但是,本实验中针对的 As 保护中断与上述两种中断不同,中断过程伴随着 As 原子与 In 原子的键合以及 As 原子与 Sb 原子在 Sb 位的竞争,以至过长或过短的中断时间都会对界 面质量造成较大影响,这是 AlSb/InAs 异质结生长应 注意的.

4.结 论

本实验研究了界面生长中采用不同 As 保护生 长中断时间对 AlSb/InAs 超晶格界面粗糙度的影响. 运用 GIXRR 对样品进行了测量和分析,并用软件对 反射曲线进行了模拟,得到超晶格界面粗糙度值,结 果表明 As 保护中断对界面粗糙度影响很大,其中 20 s As 保护中断时间得到的超晶格界面最平整.结 合电子显微镜下观察的形貌分析,我们认为对于 AlSb-InAs 界面的生长,过短的中断时间会导致界面 富 In 而形成 In 点,过长的中断时间则会导致形成较 粗糙的 AlAs 型界面.最后,讨论了异质结界面生长 的几种生长中断应用.

- [1] Nakagawa A, Kroemer H, English J H 1989 Appl. Phys. Lett. 54 1893
- [2] Weaver B D, Boos J B, Papanicolaou N A 2005 Appl. Phys. Lett.
 87 173501
- [3] Pekarik J J, Kroemer H, English J H 1992 J. Vac. Sci. Technol.
 B 10 1032
- [4] Averett K L , Wu X , Koch M W 2003 J. Crystal Growth 251 852
- [5] Chow D H , Schulman J H 1994 Appl . Phys . Lett . 64 76
- [6] Boos J B , Bennett B R , Kruppa W 2003 Solid-State Electronics 47 181
- [7] Sigmund J, Saglam M, Hartnagel H L, Zverev V N, Raichev O E, Debray P, Miehe G, Fuess H 2002 J. Vac. Sci. Technol. B 20 1174
- [8] Tuttle G , Kroeme H , English J H 1990 J. Appl. Phys. 67 3032

- [9] Wong K C , Yang C , Thomas M , Blank H R 1997 J. Appl. Phys.
 82 4904
- [10] Brar B, Ibbetson J, Kroemer H, English J H 1994 Appl. Phys. Lett. 64 3392
- [11] Tomich D H, Mitchel W C, Chow P, Tu C W 1999 J. Crystal Growth 201 868
- [12] Kaspi R , Steinshnider J , Weimer M , Moeller C , Ongstad A 2001 J. Crystal Growth 225 544
- [13] Sigmunda J, Karovaa K, Mieheb G, Saglama M, Hartnagela H L, Fuessb H 2003 J. Crystal Growth 251 256
- [14] Jenichena B , Stepanov S A , Brar B , Kroemer H 1996 J. Appl. Phys. 79 120
- [15] Liu C Y, Liu C 2003 Acta Phys. Sin. 52 1479 (in Chinese) [刘 存业、刘 畅 2003 物理学报 52 1479]

- [16] Durand O, Berger V, Bisaro R, Bouchier A, Rossi A D, Marcadet X, Prevot I 2001 Materials Science in Semiconductor Processing 4 327
- [18] M Tolan 1999 X-Ray Scattering from Soft-Matter Thin Films (New York : Springer) chapter 2

As-soak dependence of interface roughness of AISb/InAs superlattice *

Li Zhi-Hua Wang Wen-Xin[†] Liu Lin-Sheng Jiang Zhong-Wei Gao Han-Chao Zhou Jun-Ming

(Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100080, China)

(Received 26 April 2006 ; revised manuscript received 16 September 2006)

Abstract

Different As-soak time is applied during InSb-like interfaces growth of InAs/AlSb superlattices on GaA(100) substrates. The interface roughness is studied by grazing incidence X-ray reflectivity. The reflectivity curves are simulated by standard software and the rms roughness of the interfaces is obtained. It was shown that the sample with As-soak time of 20 seconds has the most smooth interfaces. By analyzing the microscope images of the samples , we suggest that In-rich interfaces will be formed with too short As-soak time and AlAs-like interfaces are obtained with too long As-soak time , and in hoth cases the interface will be cearsened. Grazing incidence X-ray reflectivity is also recommended as a powerful tool for assessing the structure of superlattices.

Keywords: MBE, growth termination, superlattice, grazing incidence X-ray reflectivity PACC: 8115, 6110F, 7340L, 7280E

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China Grant No.50572120).

[†] E-mail:wxwang@aphy.iphy.ac.cn